

高温固化正性PAE-H7011

产品名称	高温固化正性PAE-H7011
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

MINSEO PAE-1400s 负性光敏聚酰亚胺(PI)涂层胶经紫外i-线曝光后，通过显影、漂洗、热亚胺化等工序可得到形状和尺寸精度可控的立体光刻图形。由于PI层膜具有优异的高耐热、高强韧、高粘附、高电绝缘、低介电常数及损耗、高抗化学稳定性等，在微电子制造与封装领域具有广泛而重要的应用价值。其代表性应用包括，1) 多层金属布线结构的层间介质绝缘膜, 包括晶圆级封装(Fan-in WLCSP, 3D IC集成及封装, 系统级封装(SiP)及微机械封装(MEMS)等。2) 半导体芯片表面的一级和/或二级钝化层膜；3) 塑封IC电路的应力缓冲-吸收层膜。产品特点：1) 负性曝光，有机溶剂显影，膜厚范围：3-20 μm；2) 高温固化型(320-390)；3) 储存期长，工艺窗口宽；4) 固化薄膜力学性能优异，断裂伸长率大于70%；5) 低内应力；6) 与铜界面相容性好，与金属、氧化物和陶瓷等的粘结力高；7) 抗化学侵蚀性优异，可承受大多数有机溶剂、无机酸、碱溶液的腐蚀；